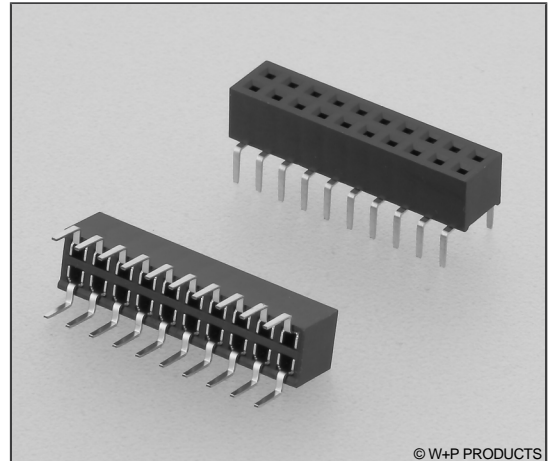


Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade, 2-reihig – BH 4,3mm, durchsteckbar Female Headers, 2.00mm Pitch, Straight, Double Row – 4.3mm Profile, Pass Through

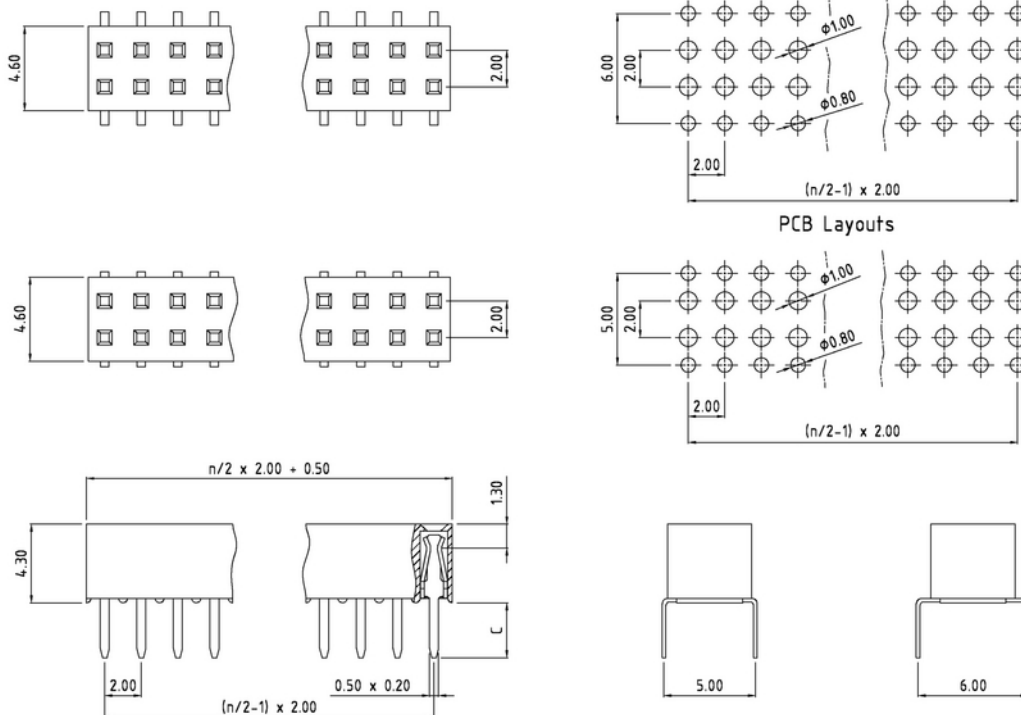
Technische Daten / Technical Data

| | |
|--|---|
| Isolierkörper <i>Insulator</i> | Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i> |
| Kontaktmaterial <i>Contact Material</i> | Kupferlegierung <i>Copper alloy</i> |
| Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i> | Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i> |
| Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i> | < 20mΩ < 20mΩ |
| Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i> | > 1000MΩ > 1000MΩ |
| Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i> | 500V _{AC} 500V _{AC} |
| Nennstrom <i>Current Rating</i> | 1A 1A |
| Temperaturbereich <i>Temperature Range</i> | -40°C ... +125°C -40°C ... +125°C |
| Verarbeitung <i>Processing</i> | Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i> |



© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für
Vierkantstifte 0,50mm.
Dual beam contacts accept
0.50mm square pins.



Series

744

Contacts*

04

04-80 Zweireihig
Double row

Spacing*

1

1 5,00; C=3,60mm
2 6,00; C=3,00mm

Plating*

00

00 Vergoldet
Gold plated
50 Verzinkt
Tin plated
60 Sel. Au/Sn
Duplex plating

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** -
please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

| Profileigenschaft | Kennwert |
|--------------------------------------|--------------|
| Temperatur Minimum T_{Smin} | 150°C |
| Temperatur Maximum T_{Smax} | 200°C |
| Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Temperatur Lötbereich T_L | 217°C |
| Verweildauer oberhalb T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Höchsttemperatur T_P | 260°C ±5 |
| Dauer Höchsttemperatur | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P | Max. 8 min |

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

| Profile Feature | Key Values |
|--------------------------------------|--------------|
| Minimum Temperature T_{Smin} | 150°C |
| Maximum Temperatur T_{Smax} | 200°C |
| Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$ | 60-180s |
| Soldering Range Temperature T_L | 217°C |
| Duration above T_L | 60-180s |
| Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$ | max. 3°C / s |
| Peak Temperature T_P | 260°C ±5 |
| Duration Peak Temperature | 20-40s |
| Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$ | 6°C / s |
| Duration 25°C - Peak Temp. T_P | Max. 8min |

